

個人投資家向け会社説明会 ミーティングメモ

ダイトロン株式会社 (7609)

開催日：2023年9月9日(土)

場所：大阪新阪急ホテル 2階 『紫の間』 (大阪府大阪市北区)

説明者：代表取締役社長 土屋 伸介 氏

1. 会社概要及び事業内容

- ・ 当社は1952年6月24日に設立し、大阪市淀川区に本社を構えています。連結従業員数は942名で、パート社員等を含めると約1,200名の規模となっています。事業内容は、電子機器および部品、各種製造装置の製造・販売、輸出入業務を中心に展開しています。
- ・ 当社は企業理念として「創業の精神」「行動規範」「経営理念」の3つを掲げています。「創業の精神」である「きびしい仕事 ゆたかな生活」は、創業者である高本善四郎が会社設立時に考えたもので、現在でも社員に非常に浸透している精神です。一生懸命仕事を行って、自分たちの生活を豊かにしていくという考えの下で日々取り組んでいます。また、「行動規範」の内容は企業理念の根幹となっています。
- ・ 設立当初の社名は大都商事株式会社でしたが、店頭公開を機にダイトエレクトロン株式会社に社名を変更しました。そして、製造子会社2社とダイトエレクトロンが統合し、2017年に現在のダイトロン株式会社となっています。
- ・ 「大都」の由来については、創業者の高本が京都府出身であり、会社の設立場所が大阪府であったことから、大阪の「大」と京都の「都」を取って大都商事と名付けました。
- ・ 創業から現在までの沿革として、50年代から60年代までは創業期となります。70年代から90年代は製販一体路線の体制確立期であり、売上を伸ばす時期でした。メーカー志向の考え方の下で、この時期に製造子会社2社を設立しています。厳しい時もありましたが、戦略を工夫しながら乗り越え、1999年には店頭公開を果たしました。
- ・ 2000年代に入ると、グローバル製販体制の確立期として、製販一体路線をベースにしながら、市場を国内のみでなく海外にも広げることに取り組んできました。この流れを現在も強化しており、さまざまな戦略を考えています。
- ・ 当社の充実した営業と生産拠点として、国内には、北は仙台から南は熊本まで23拠点があり、そのうち6カ所が工場です。海外には14拠点あり、アメリカのネブラスカ州には工場を持っています。今までヨーロッパに拠点がありませんでしたが、ついに今年4月にオランダ拠点を設立しました。海外拠点は東南アジアが中心となっていますが、ヨーロッパ拠点の設立によって、ほぼ世界中をカバーできる体制ができつつあると考えています。
- ・ 当社のビジネスモデルと強みは、商社機能のマーケティング力とメーカー機能の技術力を併せ持つことです。通常、商社が持つのは受託生産的な技術力であり、依頼された項目に対して作るケースが多いです。しかし、当社は自社独自の技術を持っており、開発

大和インベスター・リレーションズ(株) (以下、「当社」といいます。)はこの資料の正確性、完全性を保証するものではありません。ここに記載された意見等は当社が開催する個人投資家向け会社説明会の開催時点における当該会社側の判断を示すに過ぎず、今後予告なく変更されることがあります。当社は、ここに記載された意見等に関して、お客様の銘柄の選択・投資に対して何らの責任を負うものではありません。この資料は投資勧誘を意図するものではありません。当社の承諾なくこの資料の複製または転載を行わないようお願いいたします。

大和インベスター・リレーションズ

Daiva Investor Relations

および設計能力を兼ね備えています。この点が通常の商社と異なる点ではないかと思えます。

- また、市場を発掘するマーケティング力が非常に強いです。当社は国内外に 5,000 社ほどの得意先があり、約 2,000 社の仕入先と取り引きしています。この幅広い顧客層と仕入先層が、当社の大きな武器になっています。
- 現在の組織体制として、2つの本部と2つのカンパニーがあります。
- 商社機能を継ぐ M&S カンパニーは、従業員約 500 名の規模となっており、主に部品および装置の仕入販売を担っています。メーカー機能を持つ D&P カンパニーは、部品事業部門と装置事業部門から構成されています。部品事業部門は約 300 名、装置事業部門は約 150 名の人員規模となっています。
- 海外事業本部では、海外市場における販売、輸出入、海外子会社の管理を主に行っています。約 50 名の従業員に加え、現地子会社の従業員約 180 名を抱えています。また、管理本部は従業員約 60 名であり、小さな本部を意識しながら各事業を支えています。
- 当社では、電子機器および部品の販売と、製造装置関係という大きく2つの事業ユニットを持っています。また、新規事業として、データセンター向け UPS の販売およびサービスのビジネスも展開しています。
- 各ユニットの中には、それぞれセグメントがあります。電子機器および部品のユニットでは、電子部品&アセンブリ商品をはじめとして、画像関連機器・部品、半導体、エンベデッドシステム、電源機器等のセグメントがあります。製造装置のユニットでは、半導体・FPD 製造装置、電子部品製造装置のセグメントがあり、各装置の製造販売を行っています。
- セグメント別の取り扱い商品についてです。電子機器および部品のユニットにおいて、電子部品&アセンブリ商品では、コネクタやハーネスを展開しています。当社オリジナル製品である「ハーメチックコネクタ」は非常に密閉性が高く、特殊な環境で使用される付加価値の高い商品となっています。このような特殊コネクタも製造販売しています。
- また、電源機器では、UPS の電源関係の他、「超低ノイズスイッチング電源」を当社オリジナル製品として製造販売しています。ノイズを非常に嫌がる医療関係や分析装置関係では特別な電源が必要とされており、当社の製品が使用されています。
- 製造装置のユニットにおいても、多くの自社製品を展開しています。半導体・FPD 製造装置では、半導体の前工程の一部や検査工程で使用される設備等を製造しています。また、半導体の基板といわれるシリコンウェーハのプロセスで必要とされる加工装置も当社で製造販売しています。電子部品製造装置では、通信機器関連、光半導体のオプトエレクトロニクスを作るための製造装置をそろえています。加工機およびテスター関係において、当社の設備は非常に強いと自負しています。
- 取り扱い製品の用途例として、製造現場ではラインの自動化に使用されています。近年の人手不足の問題や、ヒューマンエラーをなくす観点から、各製造会社で自動化ライン

の需要が大きくなっています。当社では、画像機器や産業用 PCなどを組み合わせて、自動化ラインの中でさまざまなシステムを組み上げており、現在非常に伸びている分野です。

- ・ 医療機器では、当社が展開している低ノイズの特殊電源が非常に使用されています。その他、画像診断装置にも当社の専用カメラ等が使用されています。
- ・ 輸送用機器においては、自動化運転支援システムの中に組み込まれるセンサーやレンズ等の機器を自動車メーカーに供給しています。また、ユニットを作っている Tier1、Tier2の一部の会社にも当社の機器を供給しています。その他、鉄道車両関係のビジネスも展開しており、電車の天井に格納されている加工ケーブルのアセンブリも行っています。
- ・ また、製造ラインという大きな自動化だけでなく、局所的な機器の自動化支援も行っています。自動会計システムや自動カウントシステムなど、人手不足やヒューマンエラーの問題を少しでも解消させるための機器に、当社からカメラやレンズ、カスタム PCを供給しています。
- ・ 当社は半導体関係のビジネスも展開しています。現在、半導体関連は踊り場となっており、全体的に調整機運が強くなっています。
- ・ 半導体にはさまざまな工程がありますが、当社が強いと自負しているのは材料工程です。半導体を作る前の工程として、基板を作る工程ではシリコンウェーハが使用されています。シリコンウェーハを作るにはさまざまな加工が必要であり、その加工設備を当社で設計および製作して、各取引メーカーに販売しています。
- ・ 近年、自動車関係や電力関係で非常に成長が期待できるパワー半導体に使用されるシリコンカーバイド (SiC) という材料が注目を浴びています。この材料の基板を作るためにもさまざまな設備が必要であり、当社の加工機が多く使用されています。
- ・ 光半導体に関しても、通信を司るインフラに使用されている通信モジュールには、さまざまな電子部品が入っています。それらを作るための製造装置も当社で一部取り扱っており、「スクライブ装置」や「ブレイク装置」を展開しています。
- ・ 当社は、クラウド、5G、IoT、AI、ロボティクス、ビッグデータを核とした市場に、自社製品も含めてさまざまな製品を供給しています。当社の製品は、データセンターやスマートフォン、スマートオフィス、スマートファクトリー、自動運転支援システム、ウェアラブル機器、セキュリティ機器などで使用されています。これらの市場は、短期的に業績が上下することもあります。長期的には右肩上がりの非常に大きな成長が期待できます。引き続き、当社で独自に良い製品を作りながら、市場にしっかりと供給していきたいと思っています。

2. 中期経営計画について

- ・ 現在、第 10 次中期経営計画 (10M) を進めています。2021 年から開始し、2023 年が最終年度となる 3 年計画です。

-
- ・ 10M では「Creator for the NEXT」というグループステートメントを設定しています。グローバルな観点で市場を捉え、お客さまニーズの一步先の価値を創造し、提供するという考えです。
 - ・ スローガンには「"技術立社"として、グローバル市場で躍進する！」を掲げています。当社が商社機能とメーカー機能を併せ持つことを意識して、技術立社としています。また、国内のみならず海外市場でも成長を加速させたいという意味も込めています。
 - ・ 基本的な考え方としては、成長性を重視した経営によって、売上高と営業利益の持続的な拡大を目指します。
 - ・ 目標とする経営指標として、自己資本比率は50%以上、ROAは6%以上、ROEは12%以上を目標としています。今年上半期の終了時点の自己資本比率は43.4%となっています。また、2022年実績でROAは7%、ROEは17.5%となっており、ROAとROEに関しては既に目標を達成している状況です。
 - ・ 10Mでは4つの戦略基本方針を設けています。1つ目の戦略基本方針は「事業構造の変革を推進する！」です。事業構造の変革においては、「安定+挑戦」軸、「利益」軸、「成長」軸という3つの軸を考えています。
 - ・ 「安定+挑戦」軸としては、事業別構成比において、根幹のユニットである電子機器および部品と製造装置のポートフォリオを一定比率で組み、安定した経営を行っていきたいと考えています。また、成長も必要なため、新たな成長軸として新規事業もポートフォリオに加えています。現状は目標のバランスに到達していませんが、構成比はおおむね順調に推移しています。
 - ・ 「利益」軸としては、収益性の高いオリジナル製品の売上を一定比率確保することが重要だと考え、オリジナル製品比率25%を目標にしています。現在は16%であり、目標まで少し乖離（かいり）がある状況ですが、全体的な売上が好調に推移している中で一般商材の販売が大きく伸びたことにより、結果としてオリジナル製品比率が小さくなっています。売上自体は確実に伸びているため、今の戦略を継続させることで比率を少しでも上げたいと考えています。
 - ・ 「成長」軸としては、海外事業比率30%を目標としています。海外事業比率も現在伸びてきており、今後は海外ネットワークを広げて、電子部品関係のビジネスをさらに強化していきます。
 - ・ 2つ目の戦略基本方針は「統合効果の最大化を推進する！」です。前回の中期経営計画では、新工場の設立など建物への投資を行いました。10Mでは、エンジニアの確保、特にソフトウェア関連のエンジニアの新たな確保を考えており、人材への投資を進めていきます。
 - ・ 3つ目の戦略基本方針は「注力領域・市場を明確化し、成長を加速する！」です。今後成長が期待できる市場を狙って、活動施策を進めていきたいと考えています。
 - ・ 4つ目の戦略基本方針は「持続的成長に向け、チカラを高める！」として、「国内ビジ

ネスの補強と安定成長」、「海外ビジネスの成長」、「生産体制の強化」、「オリジナル製品ビジネスの強化」、「新規ビジネスの育成」、「事業サポート機能の改革」という6つの施策を掲げています。

- ・ 「国内ビジネスの補強と安定成長」については、地域密着営業をより一層進めたいと考えています。現在も一定の成果が出ている状況です。また、国内にも一部の空白地域があるため、新たな拠点の設立も検討しています。
- ・ 「海外ビジネスの成長」については、海外ネットワークの拡充を進めています。今回、ようやくEUのオランダに拠点を設けることができました。その前にはシンガポールに現地法人を設けており、アジアの補強も図っています。
- ・ また、オリジナル製品の生産および販売の強化を行っていきます。「生産体制の強化」については、コスト低減の施策に取り組んでいます。原価を把握しながら良い製品を作れるよう、工場別に原価計算を考える仕組みを進めている段階です。「オリジナル製品ビジネスの強化」については、強く良い製品を作ることが大事だと考え、開発に注力しています。「標準製品」を開発の一つのテーマとして設定し、部門を立ち上げてマーケティング情報を収集しながら検討しています。
- ・ 「新規ビジネスの育成」については、将来に向けて新規事業の育成を進めることが重要だと考えています。9Mから進めていたグリーン・ファシリティー部におけるデータセンター向けUPSのビジネスは、ある程度育成が進み、売上高20~30億円規模の事業になりつつあります。10Mでは、さらにこれを進めるとともに、新たにソフトウェア関連の事業に取り組みたいと考えています。ソフトウェアビジネスを一つの事業にできるよう、プロジェクトチームを作ってマーケティング調査を現在行っているところです。
- ・ 「事業サポート機能の改革」については、管理本部を中心に、人財力の強化とコーポレート部門の強化を進めています。人財力の強化としては、人事評価システムの見直し、多様な人材の採用と活躍の推進、人材育成の強化、働き方改革に取り組んでいます。コーポレート部門の強化としては、IT戦略、財務戦略、広報戦略、ガバナンスの強化を行っています。

3. サステナビリティ体系

- ・ 10Mでは、サステナビリティ活動を進めています。
- ・ 当社のサステナビリティ体系は、創業の精神と行動基準を頂点に、当社ができるサステナビリティ活動は何かを考えて重要課題を特定して、目標値を定めています。サステナビリティ委員会も設置し、最終的にはSDGsのテーマにつながる活動ができればと考えて取り組みを進めています。
- ・ サステナビリティ体系の詳細については統合報告書にも記載しているため、ぜひご覧いただければと思います。日本語版に加えて、英語版もあります。

4. 業績ハイライト

- ・ 今期上半期の業績は、前年同期比で売上高、営業利益、経常利益ともに 100%以上となっています。
- ・ 商品セグメント別の実績を見ると、電子部品&アセンブリ商品、電源機器、半導体・FPD 製造装置、電子部品製造装置は非常に利益率が良いです。これらは当社オリジナル製品を含むセグメントであるため、ここをしっかりと伸ばして一定の売上を確保することで、今後も収益率を上げていきたいと考えています。
- ・ 地域別の売上高については、まだ国内が主体となっていますが、海外も少しずつ伸びてきている状況です。特にアジア地区の売上が大きく、中でも中国と韓国の売上が大きくなっています。今後の課題としては、北米、欧州、東南アジアの比率をどのように伸ばしていくかが重要になると考えています。
- ・ 連結の財政状態については、近年、売上高および利益が非常に好調に推移できており、純資産も大きくなっています。
- ・ 四半期別の受注高推移については、昨年末をピークに、今年に入って少し受注が厳しくなっている状況です。半導体、特にメモリ関係の在庫調整が影響し、受注が調整段階に入っていることが大きな要因となっています。ただ、今後成長が期待できる市場のため、調整は一時的なものだと想定しています。次の成長に向かう時期がいつ来るのかについて、当初は 12 月末を見込んでいましたが、お客さまからさまざまな情報を聞いた上で、2024 年末になるのではないかと想定しています。長期的には確実に右肩上がり伸びる市場だと考えているため、次の転換期に向けてしっかりと準備したいと思います。
- ・ 受注残高に関しては、まだ高いレベルを維持しています。最近納期が短くなってきていますが、まだ製造装置関係では納期が長いので、比較的高い受注残高を維持できている形となっています。
- ・ 通期の連結業績予想として、売上高は 880 億円、営業利益および経常利益は 57 億 3,000 万円を見込んでいます。売上高については、前年度を少し上回る形で過去最高を更新する予定です。利益は昨年より減少する予想ですが、ほぼ同じレベルをキープできると考えています。
- ・ 商品セグメント別の業績推移も順調に成長しています。
- ・ 配当について、2023 年 12 月期は中間 50 円、期末 65 円とし、年間で 115 円を予定しています。配当性向は 32.7%となっています。
- ・ ダイトロングループは「技術で立つ会社へ」を掲げながら、エレクトロニクス業界の技術立社として社員と共に進化を果たし、グローバル市場に新たな価値を創造していきたいと考えています。

5. 質疑応答

大和インベスター・リレーションズ(株) (以下、「当社」といいます。)はこの資料の正確性、完全性を保証するものではありません。ここに記載された意見等は当社が開催する個人投資家向け会社説明会の開催時点における当該会社側の判断を示すに過ぎず、今後予告なく変更されることがあります。当社は、ここに記載された意見等に関して、お客様の銘柄の選択・投資に対して何らの責任を負うものではありません。この資料は投資勧誘を意図するものではありません。当社の承諾なくこの資料の複製または転載を行わないようお願いいたします。

Q1. 電気自動車が普及していくと、パワー半導体、SiCの需要が大きくなりますが、この需要は取り込めそうでしょうか。

A1. パワー半導体の需要が今後も伸びる中で、材料としてSiCが非常に注目されています。当社はSiC基板を作る製造装置を自社で製造販売しているため、需要は取り込めると考えています。

Q2. 昨今の円安は御社の業績にとってプラス要因でしょうか、あるいはマイナス要因でしょうか。

A2. 現在、円安が非常に進んでいます。当社では輸入と輸出を行っており、海外子会社もあるため、現在の運営形態においてはマイナス面とプラス面が相殺される形となっています。そのため、現時点で業績に大きな影響は出ていません。

Q3. オリジナル製品比率を上げるための具体的な取り組みを教えてください。

A3. 現在、技術者の確保と養成に注力しており、特にソフトウェア関連の技術者を集めています。当社のハード関係を中心とするオリジナル製品にソフトウェア関連機能を付加することで、付加価値を上げることができるとともに、お客さまへの提案力も向上すると考えています。ハードのみの製品ではなく、ソフトウェアを加えて製品の幅と販売の幅を広げることで、オリジナル製品の比率を上げていきたいと思っております。

Q4. 2本部2カンパニー制を導入して、これまでの実績において良かった点と悪かった点を教えてください。また、今後もこの制度を継続していくのでしょうか。

A4. 2本部2カンパニー制によって順調に業績が推移していると思っています。この形態がベストかどうかはまだ分かりませんが、現時点ではうまく機能しています。また、以前は交流をあまりできていませんでしたが、最近は人事交流も行っており、さまざまな経験を持つ方々をミックスする形ができてきているため、しばらく現体制を継続したいと考えています。

Q5. 株主総会後の食事会は今後も実施されますか。

A5. 株主総会後の懇親会については、新型コロナウイルス感染症の影響でここ3~4年ほど控えていました。来年3月に株主総会を予定しており、私自身は懇親会を再開できればと思っています。株主総会での質問も重要ですが、その後の懇親会における皆さまのご意見も非常に価値あるものが多いと考えています。まだ確定ではないですが、できれば懇親会の機会を設けたいと思っております。

Q6. 株主向けの工場見学会をぜひ実施してください。

A6. 工場見学会も実現させたいと考えていますが、これまで実績がなく、残念ながら実施で

きていません。しっかりとした準備が必要になり、失礼のない形で案内できればと思っています。そのため、検討事項とさせていただきます。

Q7. 欧州初の現地法人をオランダに設置されましたが、オランダを選んだ理由を教えてください。

A7. オランダを選んだ理由として、まずは、アムステルダム空港が欧州地区全土のハブ空港となっている点が挙げられます。オランダだけでなく欧州全土を見るための拠点として考えているため、移動効率が非常に良いことが一つの理由となっています。また、オランダは英語のコミュニケーションが取れやすいと聞いていたことも理由の一つです。そして、今回の拠点はアムステルダムから車で約1時間の場所に構えましたが、この地域には新しい多様な会社が集まっており、R&D系の開発事務所も多く、半導体の製造装置メーカーの大きな会社もあります。今後の自社製品開発やマーケティング販売に向けて開発の情報を集めやすい環境であり、このような背景も含めて最終的にオランダに決定しました。

Q8. 半導体の製造工程は細分化されていますが、御社の半導体製造装置はどの工程で使用されていますか。

A8. 半導体の製造工程は非常に多く、さまざまなプロセスがあります。その中で、当社が強いのは材料工程です。半導体チップを作っている基板の製造装置を自社で製造しているとともに、他社の製造装置も販売しています。さらに、前工程や後工程では非常に多くの設備が使用されていますが、当社は半導体の製造装置メーカーにも、画像機器やコネクタ、ケーブルを加工したハーネス、産業用特殊コンピュータなど、電子機器および電子部品を供給しています。また、製造装置関係も材料工程に強く、今後非常に期待できるSiCの製造装置も当社が供給しています。そのような意味では、さまざまなプロセスに当社の製品が関連しており、半導体工程の広範囲にわたって取り引きしている状況です。

以上